(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203018872 U
(45)授权公告日 2013.06.26

(21)申请号 201220670174.5

(22)申请日 2012.12.07

(73)专利权人 天水七四九电子有限公司
地址 741000 甘肃省天水市双桥路 14 号

(72)发明人 苏新越

(74)专利代理机构 甘肃省知识产权事务中心 62100
代理人 张克勤

(51)Int.Cl.
*B23K 3/00*(2006.01)
*B23K 1/018*(2006.01)

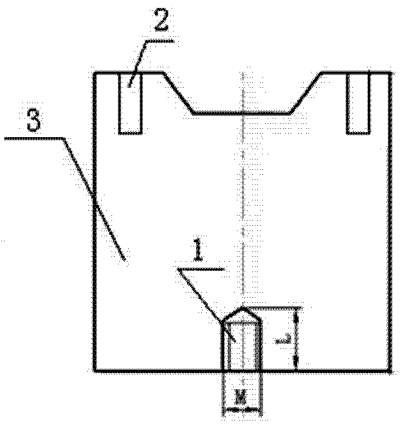
权利要求书1页 说明书2页 附图5页

(54)实用新型名称

用于 DIP 封装集成电路及老化插座拆卸的装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种用于 DIP 封装集成电路及老化插座拆卸的装置，以解决的现有的拆卸方法对不能很好的保护集成电路及线路板、工作效率低的问题。包括本体，本体上设有用于与其它部分联接的螺孔和电路管脚插孔，所述螺孔设置在本体的底部，本体的上部设有两排若干电路管脚插孔，电路管脚插孔和所拆卸的集成电路的电路管脚一一对应，相对应的电路管脚插孔和电路管脚同轴，电路管脚插孔的直径大于集成电路的管脚的直径。采用本装置进行 DIP 封装集成电路或 DIP 插座的拆卸，避免了传统方法拆卸时造成的电路或线路板损坏的现象。实现了集成电路或插座拆卸时电路或线路板无损、高效的目的，大大降低了成本，而且结构简单，便于操作。




CN 203018872 U

1. 一种用于 DIP 封装集成电路及老化插座拆卸的装置，其特征在于：包括本体（3），本体（3）上设有用于与其它部分联接的螺孔（1）和电路管脚插孔（2），所述螺孔（1）设置在本体（3）的底部，本体（3）的上部设有两排若干电路管脚插孔（2），电路管脚插孔（2）和所拆卸的集成电路的电路管脚（4）一一对应，相对应的电路管脚插孔（2）和电路管脚（4）同轴，电路管脚插孔（2）的直径大于集成电路的管脚（4）的直径。

2. 如权利要求 1 所述的用于 DIP 封装集成电路及老化插座拆卸的装置，其特征在于：所述电路管脚插孔（2）的直径比集成电路的管脚（4）的直径大 1 ～ 2mm。

3. 如权利要求 1 所述的用于 DIP 封装集成电路及老化插座拆卸的装置，其特征在于：电路管脚插孔（2）的深度大于等于 5mm，且小于本体（3）的高度。

4. 如权利要求 1 所述的用于 DIP 封装集成电路及老化插座拆卸的装置，其特征在于：同一排中相邻两个电路管脚插孔（2）的中心之间的距离等于同一排中相邻两个集成电路的管脚（4）的中心之间的距离。

5. 如权利要求 1 所述的用于 DIP 封装集成电路及老化插座拆卸的装置，其特征在于：相邻两排中两个电路管脚插孔（2）的中心之间的距离等于相邻两排中两个集成电路的管脚（4）的中心之间的距离。

6. 如权利要求 1 所述的用于 DIP 封装集成电路及老化插座拆卸的装置，其特征在于：所述本体（3）的表面粗糙度为 Ra 1.6。

# 用于 DIP 封装集成电路及老化插座拆卸的装置

## 技术领域

[0001] 本发明属于机械制造技术领域，特别涉及一种用于 DIP 封装集成电路或插座的拆卸的装置。

## 背景技术

[0002] 目前，DIP 封装集成电路或其插座在电路检修时，经常要从印刷线路板上拆卸集成电路及插座，现在经常使用的拆卸方法有：吸锡器吸锡拆卸法、医用空心针拆卸法、多股铜线吸锡拆卸法等。由于集成电路引脚多又密集，用上述方法拆卸时将每个管脚焊锡同时加热熔化起来很困难，有时还会导致集成电路和线路板损坏，并且用这些拆卸方法效率很低。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种用于 DIP 封装集成电路及老化插座拆卸的装置，以解决的现有的拆卸方法对不能很好的保护集成电路及线路板、工作效率低的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

[0005] 一种用于 DIP 封装集成电路及老化插座拆卸的装置，包括本体，本体上设有用于与其它部分联接的螺孔和电路管脚插孔，所述螺孔设置在本体的底部，本体的上部设有两排若干电路管脚插孔，电路管脚插孔和所拆卸的集成电路的电路管脚一一对应，相对应的电路管脚插孔和电路管脚同轴，电路管脚插孔的直径大于集成电路的管脚的直径。

[0006] 本实用新型的有益效果是：采用本装置进行 DIP 封装集成电路或 DIP 插座的拆卸，避免了传统方法拆卸时造成的电路或线路板损坏的现象。实现了集成电路或插座拆卸时电路或线路板无损、高效的目的，大大降低了成本，而且结构简单，便于操作。

## 附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图 2 为图 1 的侧面局部剖视图。

[0009] 图 3 为图 1 的俯视图。

[0010] 图 4 为集成电路或插座的示意图。

[0011] 图 5 为图 4 的侧视图。

[0012] 图中，1- 螺孔，2- 电路管脚插孔，3- 拆卸装置本体，4- 电路管脚，5. 电路或插座本体

## 具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型做进一步说明。

[0014] 图 4、5 是需要拆卸的集成电路或插座的示意图。

[0015] 如图 1、2、3 所示，一种用于 DIP 封装集成电路及老化插座拆卸的装置，包括本体 3，本体 3 上设有用于与其它部分联接的螺孔 1 和电路管脚插孔 2，螺孔 1 设置在本体 3 的底

部，本体 3 的上部设有两排若干电路管脚插孔 2，电路管脚插孔 2 和所拆卸的集成电路的电路管脚 4 一一对应，相对应的电路管脚插孔 2 和电路管脚 4 同轴，电路管脚插孔 2 的直径大于集成电路的管脚 4 的直径。

[0016] 如图 3 和图 4，电路管脚插孔 2 的直径 Φ 比集成电路的管脚 4 的直径 Φ1 大 1 ～ 2mm。

[0017] 如图 2，电路管脚插孔 2 的深度 d 大于等于 5mm，且小于本体 3 的高度。

[0018] 如图 3 和图 4，同一排中相邻两个电路管脚插孔 2 的中心之间的距离 A1 等于同一排中相邻两个集成电路的管脚 4 的中心之间的距离 a。

[0019] 如图 3 和图 5，相邻两排中两个电路管脚插孔 2 的中心之间的距离 D2 等于相邻两排中两个集成电路的管脚 4 的中心之间的距离 D1。

[0020] 本体 3 的表面粗糙度为 Ra 1.6。

[0021] 采用本装置进行 DIP 封装集成电路或 DIP 插座的拆卸，避免了传统方法拆卸时造成的电路或线路板损坏的现象。实现了集成电路或插座拆卸时电路或线路板无损、高效的目的，大大降低了成本，而且结构简单，便于操作。

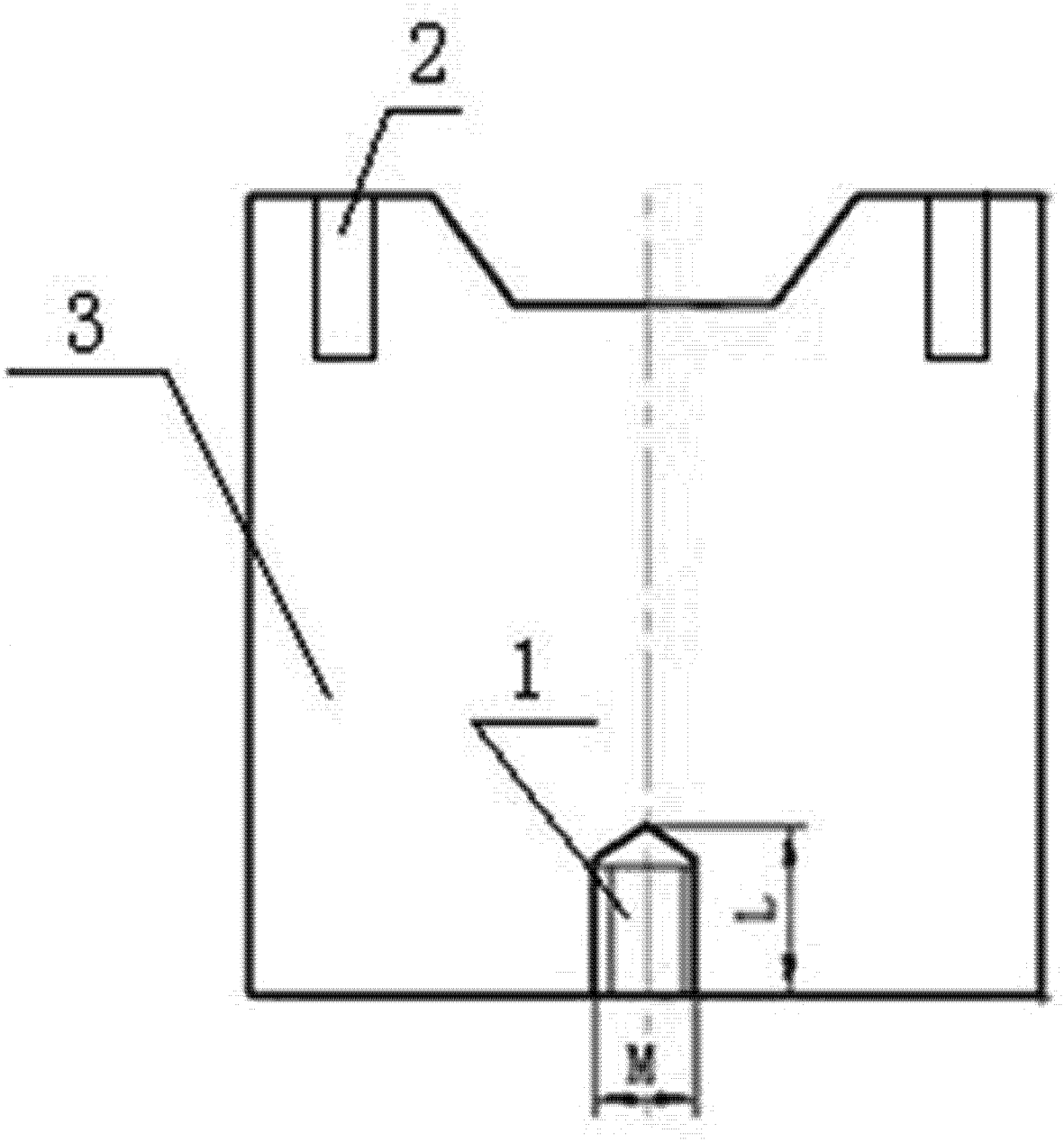



图 1

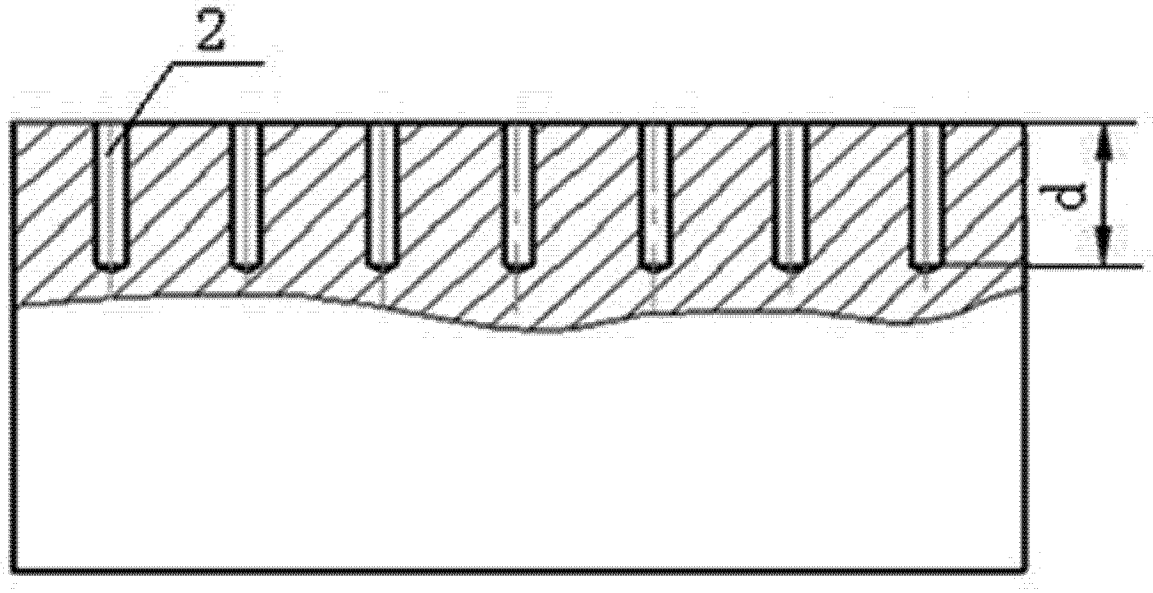



图 2

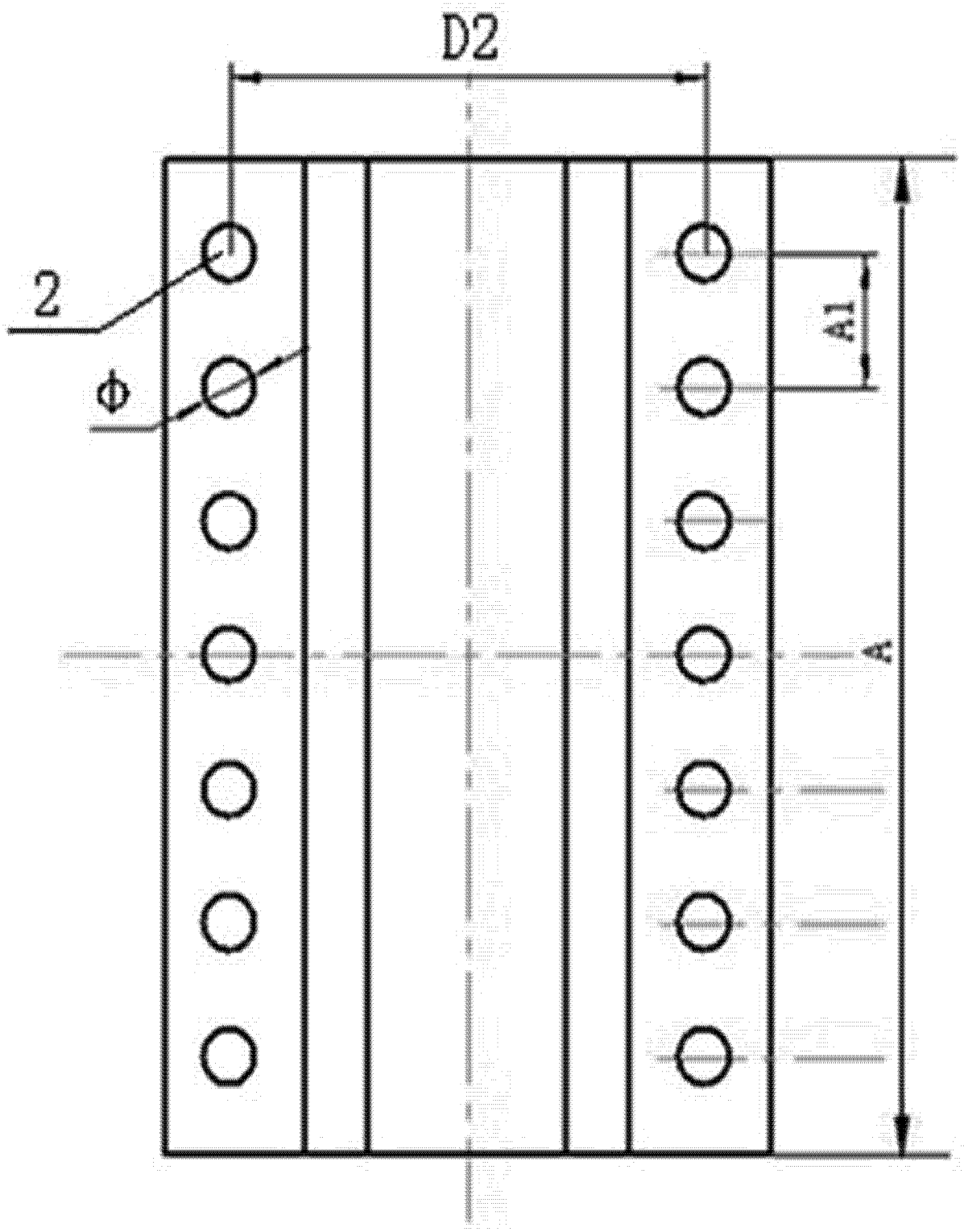



图 3

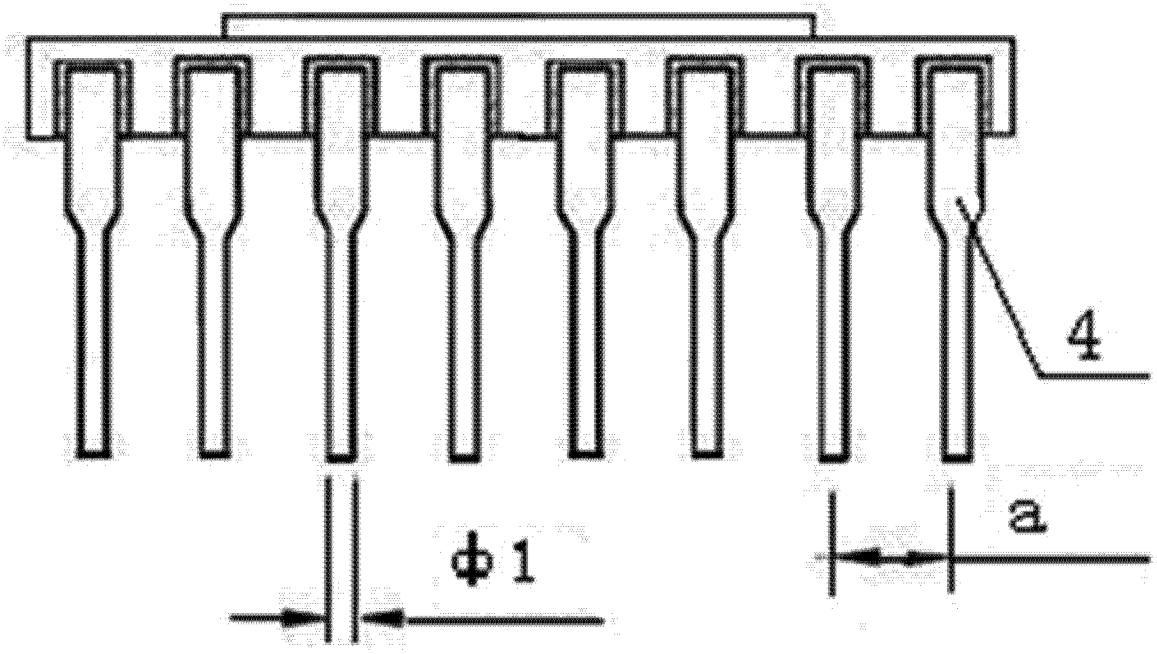



图 4

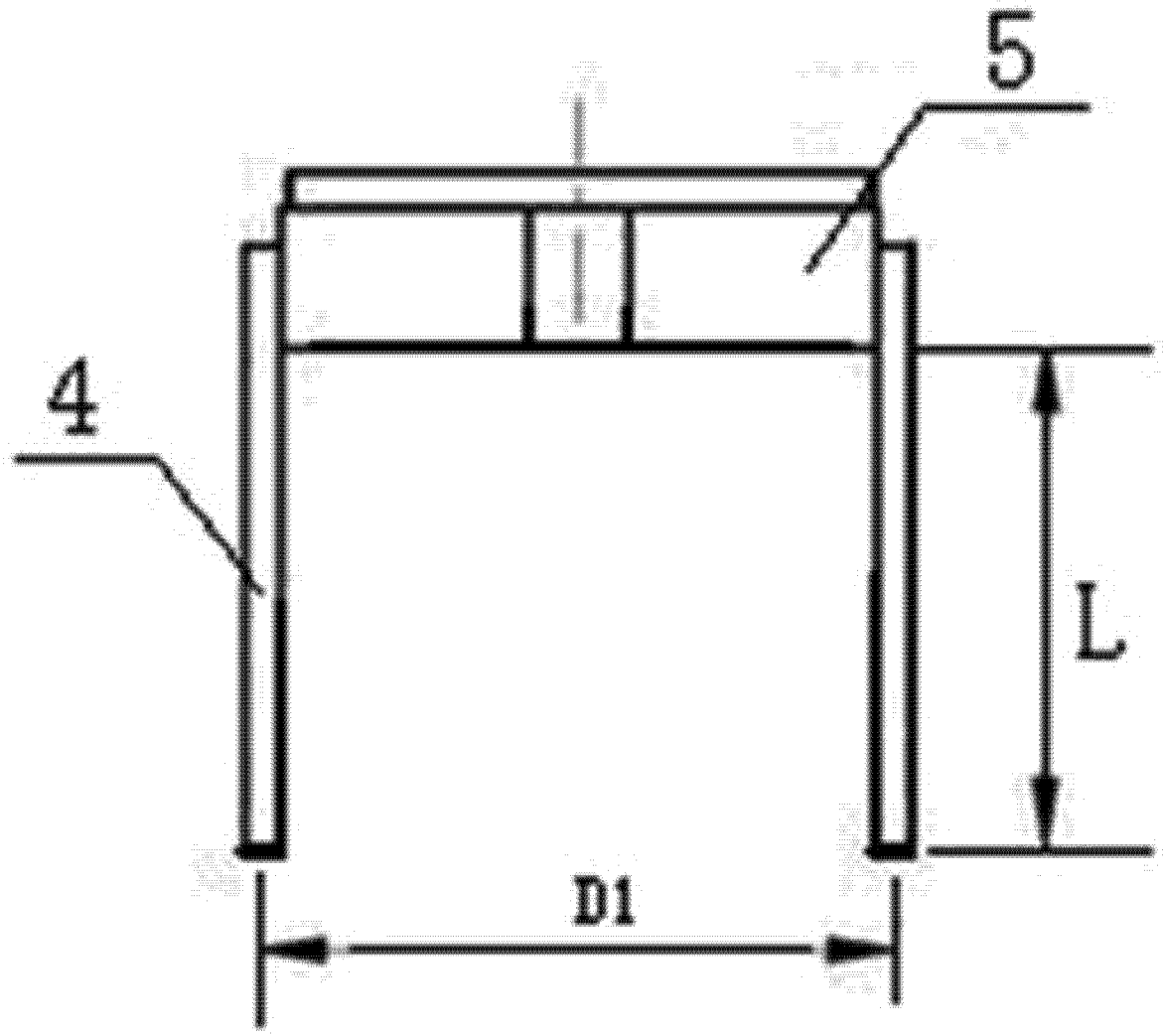



图 5